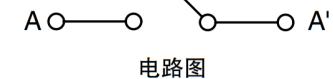
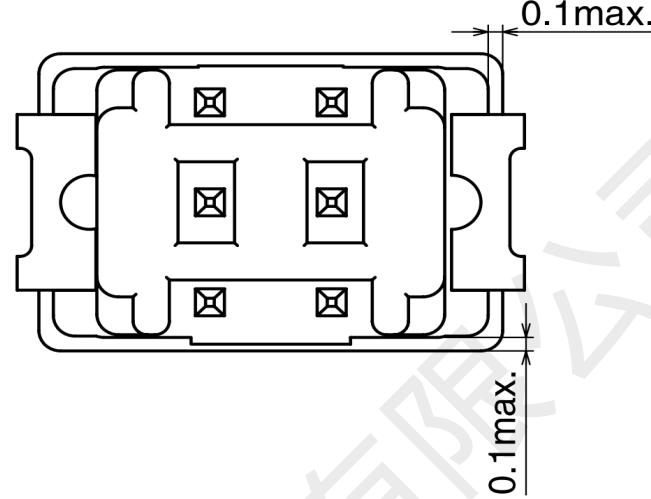
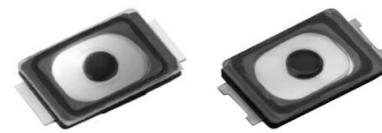
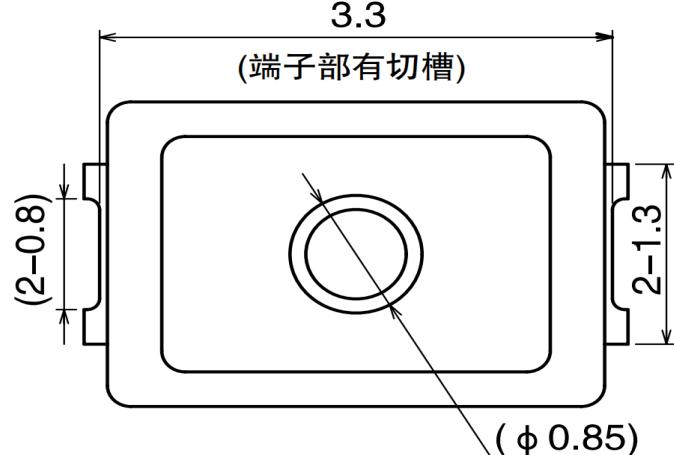
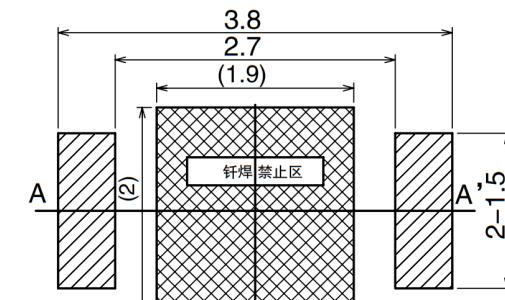


1 2 3 4 5 6 7 8



焊锡模板厚度为0.08mm
开口率为焊盘图案的60% ~ 100%。
(推荐80%)



印刷电路板焊盘参考图

* 焊锡涂层不均会导致封装钎焊失败，
因此请使用推荐焊锡层和焊盘图案。

■:推荐焊盘图案区

■:钎焊禁止区

请勿在 ■ 区域配置焊盘图案和过孔。
需配置焊盘图案或过孔时，为避免金属部分外露，
请进行绝缘涂层和抗蚀剂等处理。

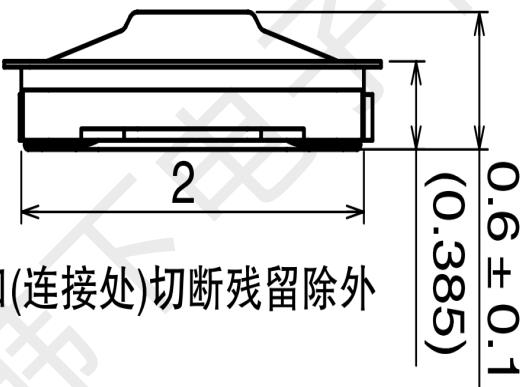
金属部分外露，可能会因焊锡球导致与开关背面
端子部之间短路。

此外，铜箔厚度和图案布局产生的凹凸差，会对开关
的倾斜和与焊锡的接合状态、助焊剂渗透造成影响。
因此，请在使用前进行验证。

SPECIFICATIONS

- Operating temperature range: -30°C to 85°C
- Rating: DC12V 50mA
- Insulation resistance: 100MΩ min 100V DC
- Dielectric strength: 250V AC for 1min.
- Contact resistance: 500mΩ Max
- Operating force: 320±30gf
- Travel: 0.15±0.05mm
- Operating life: 3,00000Cycle

浇口(连接处)切断残留除外



单 位 UNIT	mm	一般公差 GENERAL TOLERANCE	汉下® 深圳市汉下电子有限公司	
制 图 DRAW	黄彬	.X±0.5 .XX±0.2 .XXX±0.1		
设 计 DESIGN		X.±5° X.±2°		
审 核 CHECKED	张伟	材 质 MATERIAL	型 号 MODEL	HX 2x3x0.6-3.3N SPST-NO 0.05A 12V
校 准 化 STANDARD		重 量 WT.	图 号 DWG NO.	
标记 MARK.	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	核 准 APPROVE	日 期 DATE
				批 准 APPROVE
				罗小春
				表 面 积 SA.
				角 法 PROJ.
				比 例 SCALE
				10: 1
				版 本 REV.
				A0
				1
				8